

# 双抛硅片激光切割晶圆激光打孔异形切片单晶硅挖槽改小加工支持定制

产品名称	双抛硅片激光切割晶圆激光打孔异形切片单晶硅挖槽改小加工支持定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

## 产品详情

华诺激光是一家依托国际先进激光技术，致力于激光精密切割打孔精密精细加工研发和代工服务的高科技企业，拥有一支经验丰富的激光精密切割打孔技术开发和管理团队，以及超过数十台的大族激光设备，包括大族激光的紫外激光精密切割打孔设备，光纤激光精密切割打孔设备，二氧化碳激光精密切割打孔设备等先进激光精密切割打孔设备。华诺激光专注于激光精密切割、打孔、微孔、小孔、细孔加工、狭缝切割、异形切割、刻槽、挖槽、改小等加工。

可加工半导体材料：硅片、晶圆、砷化镓晶片、铌酸锂晶片等。

可加工薄膜材料：聚酰亚胺薄膜、PET、PC、PVC、ABS、PE、PP、BOPP、FPC等薄膜材料。

可加工金属材质：不锈钢、铝、合金等金属材料。

可加工非金属材料：玻璃、陶瓷、蓝宝石。

可加工厚度： 2.5mm 精度：±0.02毫米

加工效果好，精度高，边缘光滑整齐无变形。

华诺激光有限公司是一家依托国际先进激光技术，致力于激光精密精细加工研发和代工的高科技企业。华诺激光公司拥有超过300平米的万级洁净实验室和生产车间，一支经验丰富的技术开发和管理团队，和多台包括紫外激光器，超快激光器，光纤激光器，二氧化碳激光器等先进进口激光源，以及配套的加工平台，公司还拥有包括3D显微镜，激光干涉仪，红外热成像仪，二次元等检测和分析工具。